

RFDot 产品, RoHS 认证, 绿色无铅封装  
 封装类型: DIP/SO

**RoHS**

## 产品概述

HM485 是一款应用于 RS-485 和 RS-422 通信系统的收发芯片。HM485 传输和接收的数据传输率可高达 2.5Mbps。485 为半双工型。另外, 485 有驱动使能(DE)和接收使能(RE)管脚, 当关闭时, 驱动和接收输出为高阻。HM485 具有失效保护功能, 在处于接收状态时, 输入端开路或短路接收器输出为高电平。

## 产品应用

- 低功耗 RS-485 收发器
- 低功耗 RS-422 收发器
- 电平转换
- 防电磁干扰(EMI)的收发器
- 工控局域网

## 产品特点

- ◆ 静电保护(ESD): ±15kV-人体模式(HBM)
- ◆ 三态输出
- ◆ 半双工
- ◆ 总线允许多达 256 个收发器

## 芯片封装

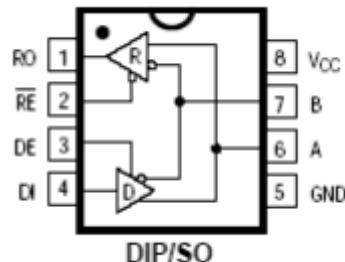


图 1 封装图

## 引脚功能描述

引脚	名字	功能
1	RO	接收输出端: A 端电压比 B 端高 200mV 时 RO 为高, A 端电压比 B 端低 200mV 时 RO 为低
2	RE	接收使能端: 低电平有效, RE 为高时, 接收输出为高阻
3	DE	发送使能端: 高电平有效, DE 为低时, 发送输出为高阻。DE 为高电平时芯片工作在发送状态, DE 为低电平且 RE 为低电平时芯片工作在接收状态。
4	DI	发送数据输入端: DI 为低时, A 输出高电平 B 输出低电平, DI 为高时正好相反。
5	GND	地, 电源负端
6	A	正向接收输入端也即正向发送输出端
7	B	反向接收输入端也即反向发送输出端
8	Vcc	电源正端

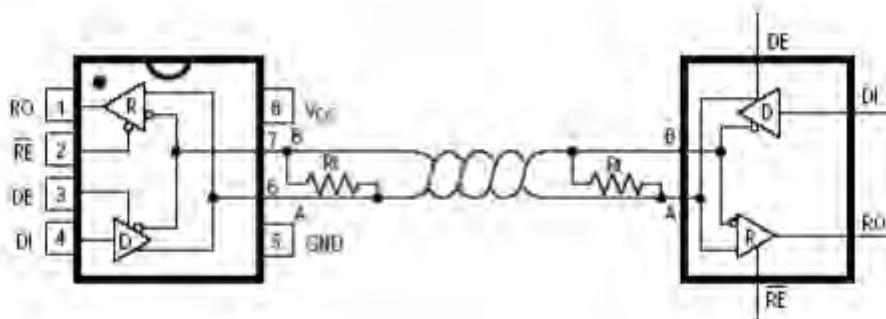


图 2 产品应用示意图

## 产品功能表

表 1 发送

输入			输出	
RE	DE	DI	Z	Y
X	1	1	0	1
X	1	0	1	0
0	0	X	High-Z	High-Z
1	0	X	High-Z	High-Z

X = 无关

High-Z = 高阻

表 2 接收

输入			输出
RE	DE	A-B	RO
0	0	$\geq +0.2$	1
0	0	$\leq -0.2$	0
0	0	输入开路	1
1	0	X	High-Z

X = 无关

High-Z = 高阻

## 产品绝对最大额定值

供电电压( $V_{CC}$ ).....	+12V
控制输入电压( $RE$ , $DE$ ).....	-0.5V 至 +12V
驱动输入电压( $DI$ ).....	-0.5V 至 +12V
驱动输出电压( $A$ , $B$ ).....	-0.5V 至 +12V
接收输入电压( $A$ , $B$ ).....	-0.5V 至 +12V
接收输出电压( $RO$ ).....	-0.5V 至 +12V
连续功率谱( $TA = +70^\circ C$ )	
8 脚塑封 DIP ( $+70^\circ C$ 以上) $-9.08mW/\text{ }^\circ C$ ).....	725mW
8 脚 SO ( $+70^\circ C$ 以上) $-5.85mW/\text{ }^\circ C$ ).....	470mW
存贮温度范围.....	-65° C 至 +160° C
工作温度范围.....	-40° C 至 +85° C
焊锡温度(10 秒).....	+300° C

最大允许额定值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

## 产品直流电学特性

( $V_{DD}=3.3V \pm 5\%$ ,  $T_a= T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}$ ) (注 1,2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
驱动差分输出(无负载)	$V_{OD1}$		2.7	3.3	5.5	V
驱动差分输出(带负载)	$V_{OD2}$	$R=30\Omega$ , 图 3	1.5	1.8		V
互补输出状态驱动差分输出电压的变化幅度	$\Delta V_{OD}$			0.2		V
驱动共模输出电压	$V_{OC}$			1.6		V
互补输出状态驱动共模输出电压的变化幅度	$\Delta V_{OC}$			0.2		V
输入高电压	$V_{IH}$	$DE, RE$	1.6			V
		DI	2			V
输入低电压	$V_{IL}$	$DE, RE$		0.8		V

		DI	1.2		
输入电流	I <sub>IN1</sub>	DE ,RE, DI	±2		uA
输入电流(A, B)	I <sub>IN2</sub>	DE = 0V; V <sub>CC</sub> = 3.3V	V <sub>IN</sub> = 3.3 V	40	100
			V <sub>IN</sub> = 0V	120	300
接收差分阈值电压	V <sub>TH</sub>			-0.2	-0.05
接收输入滞后	ΔV <sub>TH</sub>			70	mV
接收输出高电压	V <sub>OH</sub>	IO = -3mA, VID = 200mV	2.5	2.9	V
接收输出低电压	V <sub>OL</sub>	IO = 3mA, VID = -200mV	0.2	0.4	V
接收三态（高阻）输出电流	I <sub>OZR</sub>	0.4V ≤ VO ≤ 2.4V	±1		uA
接收输入阻抗	R <sub>IN</sub>			48	KΩ
无负载供电电流	I <sub>CC</sub>	RE、 DI=0 or V <sub>CC</sub>	DE=V <sub>CC</sub>	0.8	1.2
			DE=0	0.7	1.2
驱动短路电流 (VO = High)	I <sub>OD1</sub>	DE=RE=3.3V DI=0 V <sub>A</sub> =3.3V	60	100	mA
驱动短路电流 (VO = Low)	I <sub>OD2</sub>	DE=RE=3.3V DI=0 V <sub>B</sub> =0	60	100	mA
接收短路电流	I <sub>OSR</sub>	0V ≤ VO ≤ V <sub>CC</sub>	20	60	mA
ESD 保护	A, B, Y and Z pins, tested using Human Body Model		±15		kV

(V<sub>dd</sub>=5V±5%, Ta= T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>) (注 3,4)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
驱动差分输出(无负载)	V <sub>OD1</sub>		2.7	5	5.5	V
驱动差分输出(带负载)	V <sub>OD2</sub>	R=50 Ω , 图 3	2	3.6		V
互补输出状态驱动差分输出电压的变化幅度	ΔV <sub>OD</sub>			0.2		V
驱动共模输出电压	V <sub>OC</sub>			3		V
互补输出状态驱动共模输出电压的变化幅度	ΔV <sub>OC</sub>			0.2		V
输入高电压	V <sub>IH</sub>	DE ,RE	2			V
		DI	2.8			V
输入低电压	V <sub>IL</sub>	DE ,RE		0.8		V
		DI		1.6		

输入电流	I <sub>IN1</sub>	DE ,RE, DI		±2	uA
输入电流(A, B)	I <sub>IN2</sub>	DE = 0V; VCC = 5V	V <sub>IN</sub> = 5V	60	150
			V <sub>IN</sub> = 0	180	400
接收差分阈值电压	V <sub>TH</sub>			-0.2	0.2
接收输入滞后	ΔV <sub>TH</sub>			70	mV
接收输出高电压	V <sub>OH</sub>	IO = -4mA, VID = 200mV		3.5	4.5
接收输出低电压	V <sub>OL</sub>	IO = 4mA, VID = -200mV		0.2	0.4
接收三态（高阻）输出电流	I <sub>OZR</sub>	0.4V ≤ VO ≤ 2.4V		±1	uA
接收输入阻抗	R <sub>IN</sub>			48	kΩ
无负载供电电流	I <sub>CC</sub>	RE、 DI=0 or V <sub>cc</sub>	DE=V <sub>CC</sub>	1.2	1.6
			DE=0	1.1	1.5
驱动短路电流 (VO = High)	I <sub>OSD1</sub>	DE=RE=5V DI=0 V <sub>A</sub> =5V		120	250
驱动短路电流 (VO = Low)	I <sub>OSD2</sub>	DE=RE=5V DI=0 V <sub>B</sub> =0		120	250
接收短路电流	I <sub>OSR</sub>	0V ≤ VO ≤ VCC		60	100
ESD 保护	A, B, Y and Z pins, tested using Human Body Model			±15	kV

## 开关特性

(V<sub>dd</sub>=3.3V±5%, Ta=T<sub>MIN</sub> to T<sub>MAX</sub>) (注 1,2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
驱动输入到输出	t <sub>PLH</sub>	图 5, 图 8, R <sub>diff</sub> =60 Ω , CL1=CL2=100pF,	30	60	90	ns
	t <sub>PHL</sub>		40	70	100	ns
驱动输出压摆到输出	t <sub>SKEW</sub>		10			ns
驱动上升与下降时间	t <sub>R</sub>		70	100		ns
	t <sub>F</sub>		40	100		ns
驱动开启到输出为高	t <sub>ZH</sub>	图 6, 图 10, CL=100pF, S2 关闭	90	120		ns
驱动开启到输出为	t <sub>ZL</sub>	图 6, 图 10, CL=100pF,	100	120		ns

低		S1 关闭			
驱动从低到关闭	$t_{LZ}$	图 6, 图 10, CL=100pF, S1 关闭	120	150	ns
驱动从高到关闭	$t_{HZ}$	图 6, 图 10, CL=100pF, S2 关闭	120	150	ns
接收输入到输出   $t_{PLH} - t_{PHL}$   差分 接收压摆	$t_{PLH}$	图 5, 图 9, Rdiff=60 Ω , CL1=CL2=100pF,	20	75	200
	$t_{PHL}$		20	80	200
	$t_{SKD}$		10		ns
接收开启到输出为 低	$t_{ZL}$	图 4, 图 11, CL=22pF, S2 关闭	40	90	ns
接收开启到输出为 高	$t_{ZH}$	图 4, 图 11, CL=22pF, S1 关闭	60	90	ns
接收从低到关闭	$t_{LZ}$	图 4, 图 11, CL=22pF, S2 关闭	80	120	ns
接收从高到关闭	$t_{HZ}$	图 4, 图 11, CL=22pF, S1 关闭	80	120	ns
最大数据率	$f_{MAX}$		2.5		Mbps

(Vdd=5V±5%, Ta= TMIN to TMAX) (注 3,4)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
驱动输入到输出	$t_{PLH}$	图 5, 图 8, Rdiff=50 Ω , CL1=CL2=100pF,	40	70	90	ns
	$t_{PHL}$		10	40	60	ns
驱动输出压摆到输 出	$t_{SKEW}$		30			ns
驱动上升与下降时 间	$t_R$		40	60		ns
	$t_F$		40	60		ns
驱动开启到输出为 高	$t_{ZH}$	图 6, 图 10, CL=100pF, S2 关闭	50	70		ns
驱动开启到输出为 低	$t_{ZL}$	图 6, 图 10, CL=100pF, S1 关闭	50	70		ns
驱动从低到关闭	$t_{LZ}$	图 6, 图 10, CL=100pF, S1 关闭	100	120		ns
驱动从高到关闭	$t_{HZ}$	图 6, 图 10, CL=100pF, S2 关闭	90	110		ns
接收输入到输出	$t_{PLH}$	图 5, 图 9, Rdiff=50 Ω , CL1=CL2=100pF,	20	60	200	ns
	$t_{PHL}$		20	40	200	ns
$t_{PLH} - t_{PHL}$   差分 接收压摆	$t_{SKD}$		20			ns
接收开启到输出为 低	$t_{ZL}$	图 4, 图 11, CL=15pF, S2 关闭	50	80		ns

接收开启到输出为高	$t_{ZH}$	图 4, 图 11, $CL=15pF$ , S1 关闭	60	90	ns
接收从低到关闭	$t_{LZ}$	图 4, 图 11, $CL=15pF$ , S2 关闭	50	80	ns
接收从高到关闭	$t_{HZ}$	图 4, 图 11, $CL=15pF$ , S1 关闭	60	90	ns
最大数据率	$f_{MAX}$		2.5		Mbps

注 1: 所有典型情况指  $VDD=3.3V$ ,  $Ta=25^{\circ}C$ ;

注 2: 所有输入到管脚的电流为正, 所有从管脚输出的电流为负; 如无特别指出, 则电压指对地电压;

注 3: 所有典型情况指  $VDD=5V$ ,  $Ta=25^{\circ}C$ ;

注 4: 所有输入到管脚的电流为正, 所有从管脚输出的电流为负; 如无特别指出, 则电压指对地电压;

## 产品测试电路

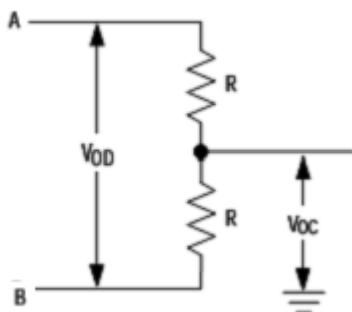


图 3 直流驱动测试电路

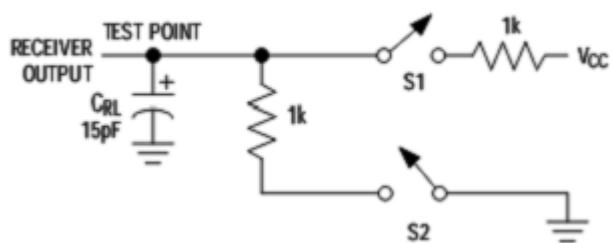


图 4 接收时间测试电路

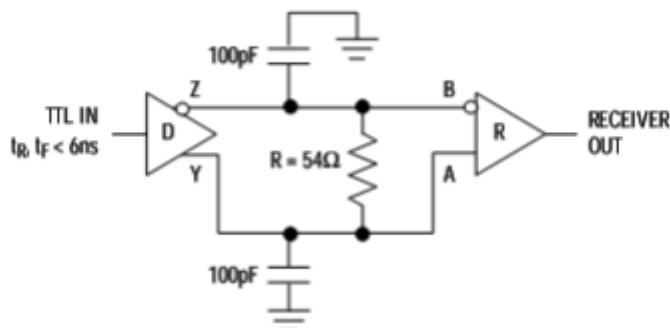
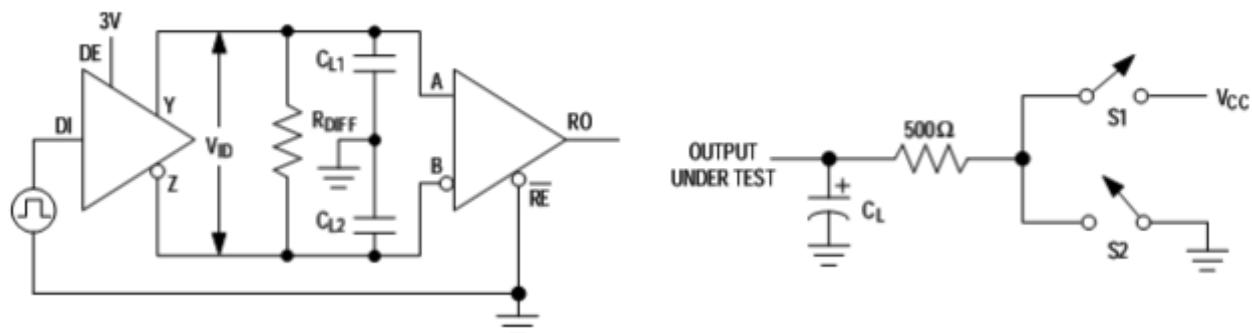


图 7 接收传输延时测试电路

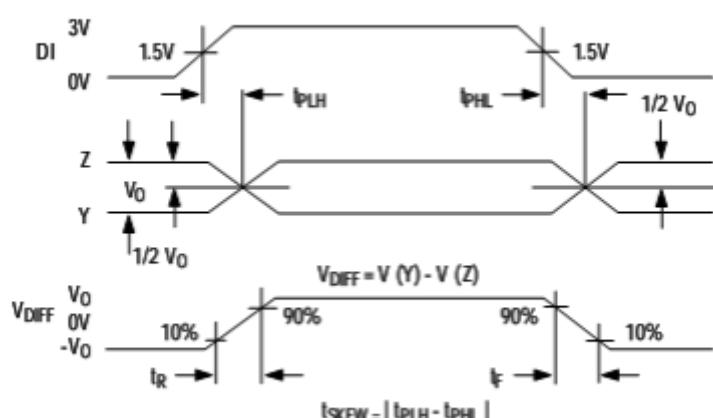


图 8 驱动传输延时

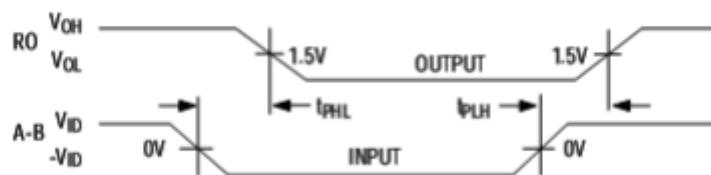


图 9 接收传输延时

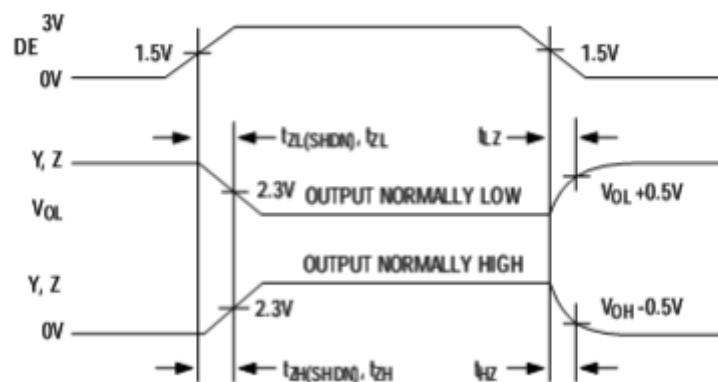


图 10 驱动开启和关闭时间

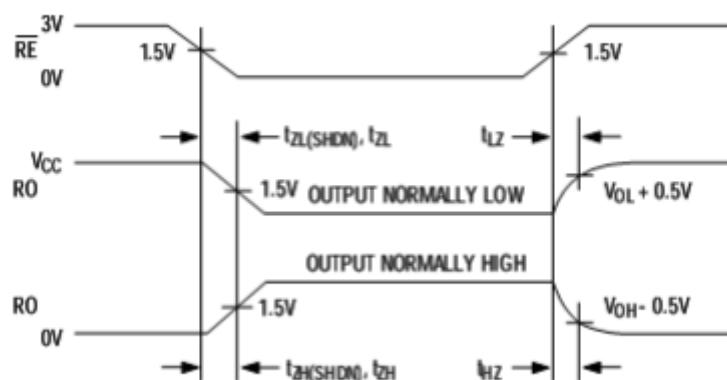


图 11 接收开启和关闭时间

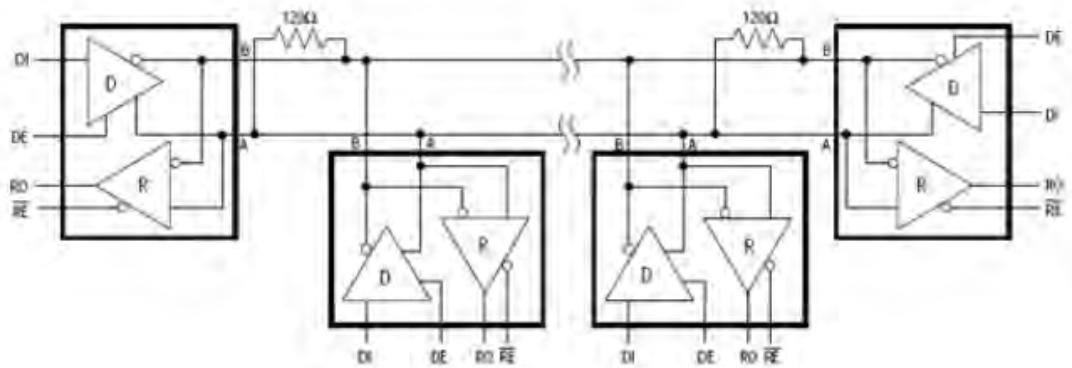


图 12 典型双工 RS-485 网络

- ◆ 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。
- ◆ 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另外，应用电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。
- ◆ 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。
- ◆ 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- ◆ 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。